

半导体器件制造微专业录取学生名单

开设二级学院（盖章）：

序号	微专业名称	学生姓名	二级学院	原专业	班级	学号
1	半导体器件制造	韦尚诗	机械学院	汽车	2311	231002380104
2	半导体器件制造	张智策	机械学院	机械设计制造及其自动化	机制卓越2211	221002200102
3	半导体器件制造	沈阳	机械学院	智能制造工程	智造2112	231102370231
4	半导体器件制造	张佑年	机械学院	智能智造	智能智2111	211002800108
5	半导体器件制造	陈博翔	机械学院	智能制造工程	智能智2111	211002800118
6	半导体器件制造	李秋荻	材料学院	电子封装技术	封装2111	211002520128
7	半导体器件制造	张宇轩	材料学院	电子封装技术	封装2111	211002520115
8	半导体器件制造	邓智豪	材料学院	焊接技术与工程	焊接2211	221002500120
9	半导体器件制造	李延昊	材料学院	材料科学与工程	材料2111	211002710104
10	半导体器件制造	张思琪	材料学院	材料成型及控制工程	材料2111	211002460132
11	半导体器件制造	荆世雄	电气学院	自动化	自动化2214	221001290415
12	半导体器件制造	王智帆	电气学院	测控技术与仪器	2211	221001700410
13	半导体器件制造	黄子烨	电气学院	测控技术与仪器	测控2211	221001700428
14	半导体器件制造	马紫卿	电气学院	电气工程及其自动化	电气2113	211001120304
15	半导体器件制造	王菁	电气学院	电气工程及其自动化	电气2213	221001120327
16	半导体器件制造	甘建彬	材料学院	材料科学与工程	材料2211	221002710108
17	半导体器件制造	温舒雅	材料学院	电子封装技术	封装2211	221002520103
18	半导体器件制造	郑瑜	材料学院	焊接技术与工程	焊接2111	211002500108
19	半导体器件制造	陈大强	材料学院	焊接技术与工程	焊接2111	211002500128
20	半导体器件制造	阿巴斯·艾斯克	材料学院	焊接技术与工程	焊接2111	211002500107
21	半导体器件制造	肖清洪	材料学院	材料科学与工程	材料2211	221002710118
22	半导体器件制造	张成柱	材料学院	材料科学与工程	材料2011	201002710129
23	半导体器件制造	杨胜概	材料学院	材料科学与工程	材料2011	191002710106
24	半导体器件制造	马春雪	材料学院	材料成型及控制工程	材料2212	221002460201
25	半导体器件制造	朱成奇	材料学院	材料成型及控制工程	材料2212	221002460234
26	半导体器件制造	王宜博	机械学院	新能源汽车工程	新车2111	211002380227
27	半导体器件制造	汤健	机械学院	车辆工程	车辆2111	211002380226
28	半导体器件制造	解伟业	材料学院	材料科学与工程	材料2211	221002710127
29	半导体器件制造	侯禹竹	材料学院	材料科学与工程	材料2011	201002710104
30	半导体器件制造	潘笑歌	材料学院	电子封装技术	封装2211	221002520110
31	半导体器件制造	王宝鸿	电气学院	电气工程及其自动化	电气2211	221001120108
32	半导体器件制造	田伟昊	材料学院	材料科学与工程	材料2111	211004710105
33	半导体器件制造	曹喆	电气学院	电气工程及其自动化	电气2211	221001120103
34	半导体器件制造	何鹏	材料学院	材料成型及控制工程	材料2211	221002460135
35	半导体器件制造	徐承昊	机械学院	智能制造工程（智能）	智能智2213	221002800303
36	半导体器件制造	陈俊錡	材料学院	材料科学与工程	材料2211	221002710119
37	半导体器件制造	武龙	材料学院	材料成型及控制工程	材料2211	221002460113
38	半导体器件制造	谢艺斐	材料学院	材料科学与工程	材料2211	221002460118
39	半导体器件制造	巨敏	机械学院	机械设计制造及其自动化	机制2315	231002200518